

# Hirata

The Global Production Engineering Company

## 2018年3月期 第2四半期 決算説明資料

平田機工株式会社



# I. 決算状況

2018年3月期 第2四半期

Hirata

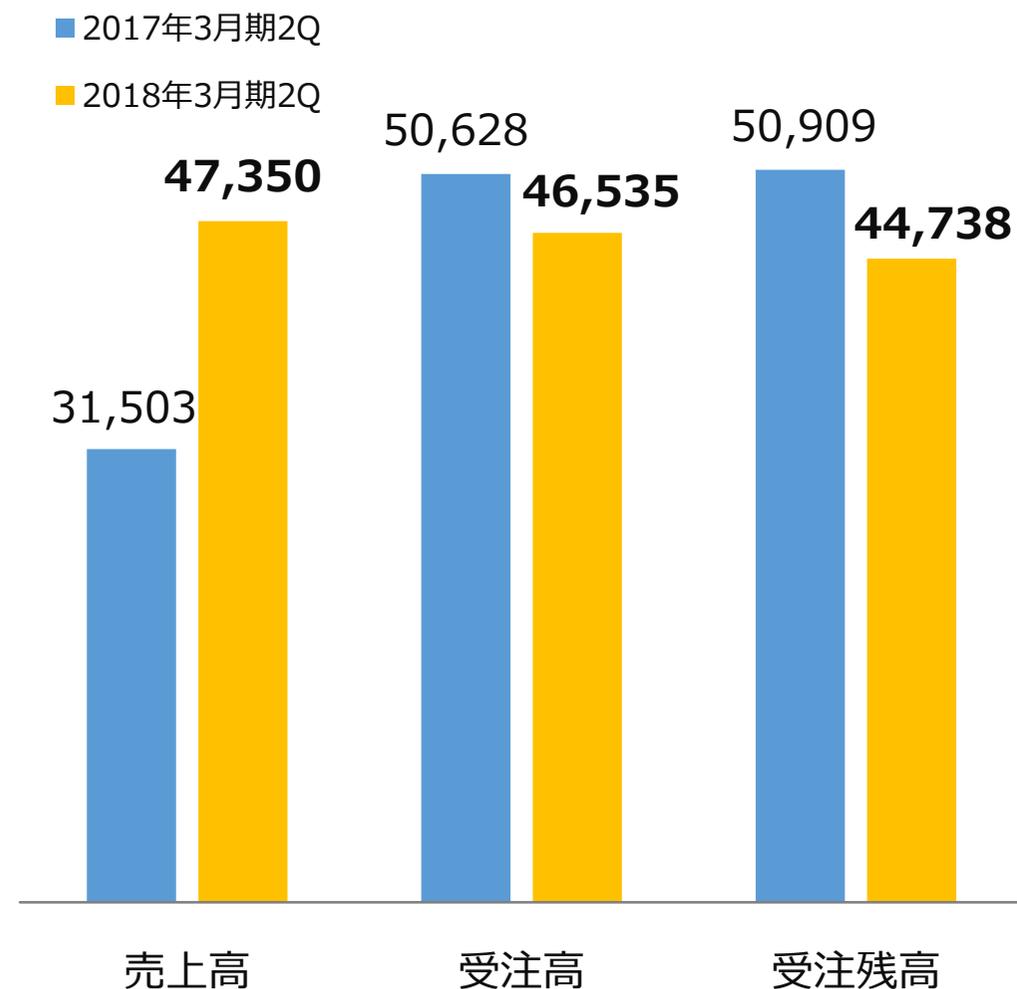


## 決算概要

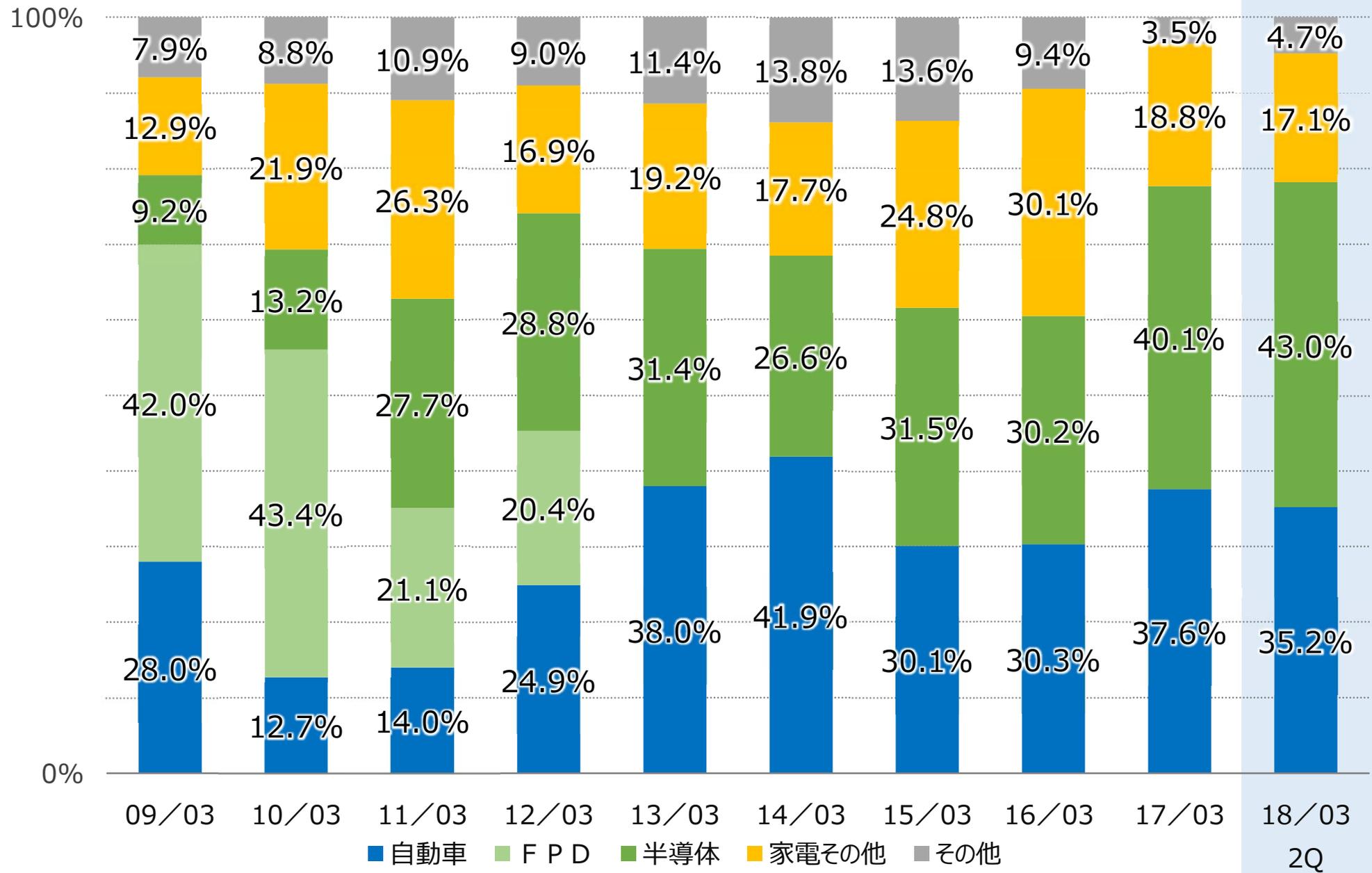
有機EL蒸着装置を中心に半導体関連生産設備事業が増収となり、自動車関連生産設備事業においても、北米メーカー向けのパワートレイン関連設備に加え、電気自動車（EV）メーカーへの売上などにより増収。

（単位：百万円）

	2017年3月期 2Q実績	2018年3月期 2Q実績	増減率
売上高	31,503	<b>47,350</b>	+50.30%
営業利益	3,287	<b>5,807</b>	+76.66%
経常利益	2,964	<b>5,616</b>	+89.46%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,903	<b>3,966</b>	+108.35%

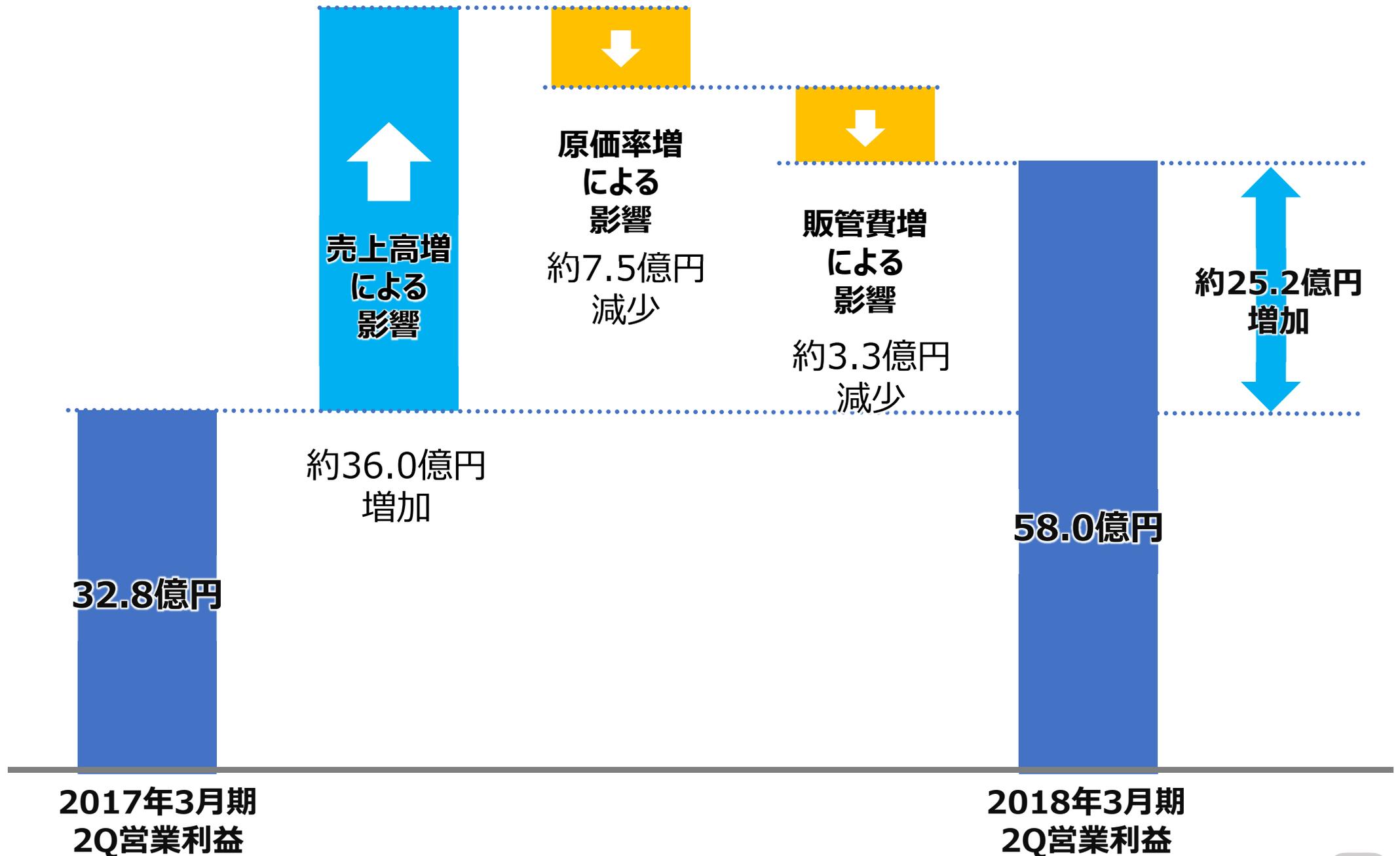


# I 決算状況 事業部門別売上高構成比推移



※2013年3月期より、FPD関連事業は半導体関連事業に統合

# I 決算状況 営業利益の増減要因分析



## 貸借対照表

(単位：百万円)

資産	2017年 3月期	2018年 3月期2Q	増減
流動資産	67,466	<b>79,792</b>	<b>+12,325</b>
固定資産	20,780	<b>21,800</b>	<b>+1,020</b>
有形固定資産	16,248	<b>16,375</b>	<b>+126</b>
無形固定資産	623	<b>802</b>	<b>+178</b>
投資その他資産	3,907	<b>4,623</b>	<b>+715</b>
資産合計	88,246	<b>101,592</b>	<b>+13,346</b>

負債	2017年 3月期	2018年 3月期2Q	増減
流動負債	48,217	<b>46,069</b>	<b>△2,147</b>
固定負債	12,457	<b>11,683</b>	<b>△774</b>
負債合計	60,674	<b>57,752</b>	<b>△2,921</b>
<b>純資産</b>			
純資産合計	27,571	<b>43,840</b>	<b>+16,268</b>
自己資本比率	30.9%	<b>42.8%</b>	<b>+11.9Point</b>

### 主な増減項目

#### 資産

現金及び預金	+9,026
売上債権	+2,164
仕掛品	+2,054

#### 負債・純資産

資本剰余金	+11,872
有利子負債	△1,663
仕入債務	+112

## 想定為替レート

(単位：円)

想定為替レート	2017年4月1日～9月30日 実績レート	2017年10月1日～ 想定レート
為替レート (対US \$)	111.72円	100.00円

## 株価推移

(単位：円)

株価推移	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年3月期		
			7月	8月	9月
最高	3,100	9,560	12,700	12,500	11,570
最低	782	2,275	10,490	10,970	10,100
末日	2,752	9,010	12,490	11,300	11,380

## PER/PBR/ROE

PER/PBR/ROE	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期2Q
PER (倍)	16.08	14.43	—※
PBR (倍)	1.22	3.12	2.80
ROE (%)	8.00	24.30	—※

※PER・ROEについては、四半期の利益では比較に適さないため記載しておりません。

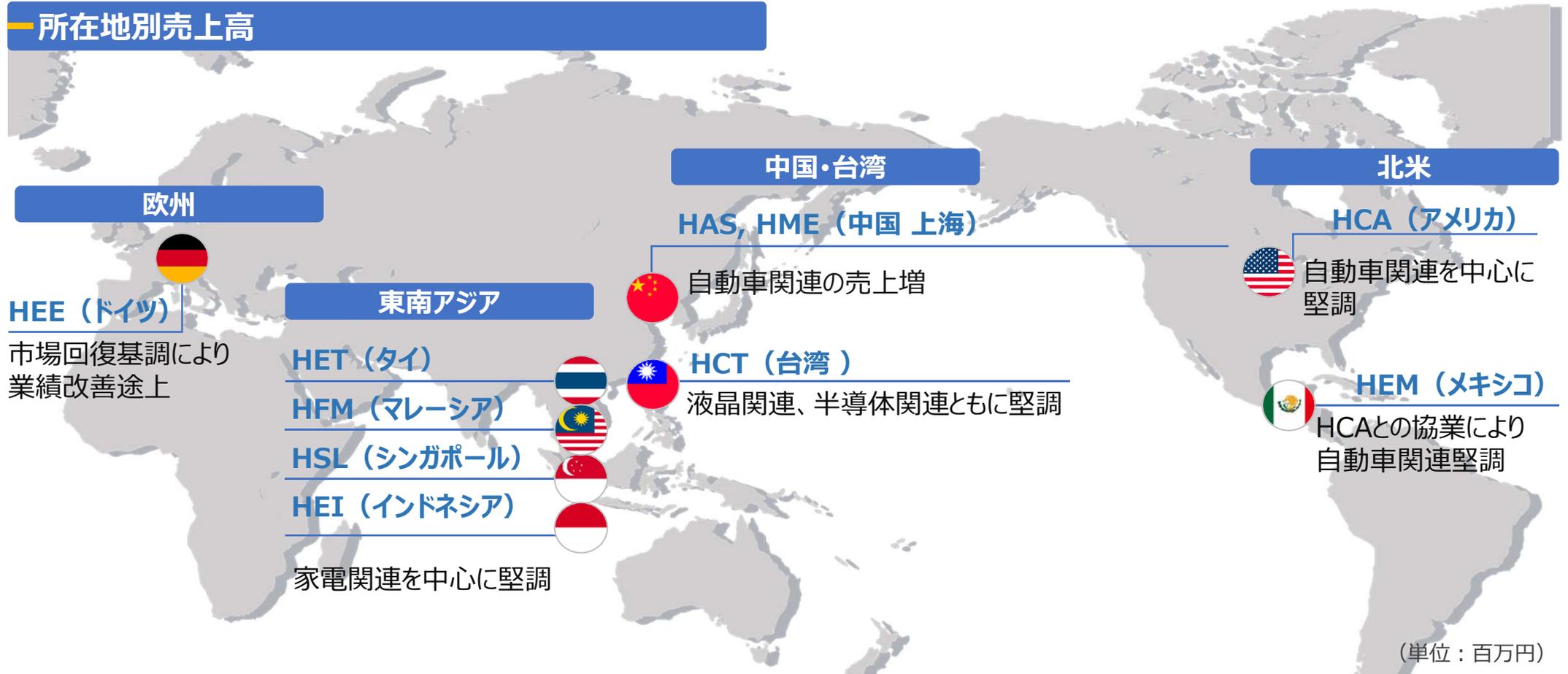
# I 決算状況 事業部門別売上高・受注高・受注残高

(単位：百万円)

	事業部門	2017/3 第2四半期	2018/3 第2四半期	対前年同期比 増減率
売上高	自動車	10,791	16,676	+54.5%
	半導体	13,825	20,357	+47.2%
	家電関連およびその他	5,550	8,075	+45.5%
	その他	1,336	2,240	+67.7%
	合計	31,503	47,350	+50.3%
受注高	自動車	22,098	10,911	△50.6%
	半導体	19,283	23,315	+20.9%
	家電関連およびその他	6,077	11,028	+81.5%
	その他	3,169	1,279	△59.6%
	合計	50,628	46,535	△8.1%
受注残高	自動車	26,473	19,620	△25.9%
	半導体	14,270	15,870	+11.2%
	家電関連およびその他	7,414	7,830	+5.6%
	その他	2,750	1,416	△48.5%
	合計	50,909	44,738	△12.1%

# I 決算状況 海外現地法人の状況

## 所在地別売上高



	日本		アジア		北米		欧州		合計	
	17/3 2Q	<b>18/3 2Q</b>								
売上高	27,349	<b>40,615</b>	1,964	<b>4,045</b>	2,004	<b>2,383</b>	185	<b>305</b>	31,503	<b>47,350</b>
営業利益	3,291	<b>5,448</b>	△29	<b>394</b>	90	<b>137</b>	△12	△9	3,340	<b>5,970</b>

※営業利益の合計はセグメント間の消去を行う前の金額を表示しています。

## 有機EL関連・電気自動車関連状況

### ●有機EL関連設備、電気自動車関連生産設備ともに高い水準で受注・売上に寄与

(単位：百万円)

	2017年3月期2Q		2018年3月期2Q	
	受注高	売上高	受注高	売上高
有機EL関連	11,180	7,114	13,528	12,781
電気自動車 (EV) 関連	7,000	95	1,663	4,429

#### ●有機EL関連

有機EL関連の売上は、前年同期比約80%増となり、半導体関連の売上のうち、約63%と大きな割合を占めております。また、受注高は前期同比約21%増となりました。

#### ●電気自動車 (EV) 関連

電気自動車 (EV) 関連は、自動車関連の売上のうち約27%となります。

主力であるパワートレインに続く割合となっており、業績に大きく貢献しております。

# I 決算状況 トピックス

## ベゼルレス・スマートフォンのニーズに対応 新型レーザー切断システム

2017年9月、スマートフォンやタブレット用パネルの生産に使用する新型レーザーパネル切断システムを開発したことを発表し、10月から販売を開始いたしました。

近年、スマートフォンのベゼルレス化※が急激に進み、各社スマートフォンの外形デザインに合わせたパネルの加工・切断が必要になってきました。これまでは長方形のパネルを機械加工により研磨していましたが、本システムでは超短パルスレーザーを活用し、パネルのコーナー部分のCカットやRカット、カメラ部分などの細かい加工・切断に対応。パネルへの熱影響も少なく高速加工・切断が可能です。



外観、幅7m×奥行3m、高さ2m

### ※ベゼルレス化

スマートフォンの外枠部分を可能な限り狭くすること。小型なスマートフォンでも画面を大きくすることができ、操作しやすい。

これまでのスマートフォン



ベゼルレス・スマートフォン



## 中国子会社にてスカラ型ロボットの生産・販売を開始

当社の中国子会社である Hirata Automated Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.（以下、HAS）において、2017年7月からスカラ型ロボット「AR-F」の生産・販売を開始いたしました。

これまで本製品の中国販売は、日本で生産し、輸送しておりましたが、HAS においても調達、品質検査、生産・販売などの全てが対応できるようになり、課題であったコストダウンとリードタイム短縮を実現することができました。

今後、中国市場の旺盛な需要に応えられるよう、既存販売ネットワークを活かした拡販・競争力の強化を図ってまいります。また、HAS にて生産・販売できるロボットのバリエーションを拡充し、中国ロボット市場に対してより積極的に参入いたします。



中国子会社 HASの工場外観



スカラ型ロボット「AR-F」

# Ⅱ. 2018年3月期業績の見通し

2018年3月期 第2四半期

Hirata



(単位：百万円)

	2017年3月期 実績		2018年3月期 予想	
<b>売上高</b>	80,542		<b>90,000</b>	
自動車関連	30,267		<b>34,000</b>	
半導体関連	32,289		<b>34,000</b>	
家電関連およびその他	15,165		<b>18,000</b>	
その他	2,819		<b>4,000</b>	
<b>営業利益（率）</b>	8,247	(10.2%)	<b>9,000</b>	<b>(10.0%)</b>
<b>経常利益（率）</b>	8,039	(10.0%)	<b>8,800</b>	<b>(9.8%)</b>
<b>親会社株主に帰属する 当期純利益（率）</b>	5,891	(7.3%)	<b>6,000</b>	<b>(6.7%)</b>

### 通期業績予想の理由および事業計画達成のための施策

自動車関連では、トランスミッションなどのパワートレイン関連の生産設備の受注は堅調であり、低燃費エンジンや電気自動車（EV）などの大型引合案件のさらなる受注確保に向けて取り組む。また、半導体関連では、有機ELディスプレイの蒸着装置、ウェーハ搬送装置共に堅調に推移。

生産高が高水準で推移するため、負荷調整に取り組みつつ、売上高の確保を図る。

## II 2018年3月期業績の見通し 配当予想の修正

### 1株あたり配当金・配当性向 推移

(単位：円)

	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	<b>2018年 3月期予想</b>
<b>1株あたり配当金</b>	12.50	15.00	30.00	100.00	<b>125.00</b> うち記念配当25.00円
<b>配当性向 (%)</b>	15.5	16.4	17.5	16.0	<b>21.1</b>

※11月13日に配当予想修正発表いたしました。  
※配当性向は連結ベースです。

### 配当予想修正の理由

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しながら安定した配当を継続していくことを基本としつつ、一方で経営業績に応じた弾力的な配当を実施することも肝要であると考えており、業績、経営環境および財務状況等を総合的に勘案した上で決定しております。

2017年6月15日、当社は東京証券取引所第一部に上場市場を変更いたしました。つきましては、株主の皆様のご支援に報いるため、平成30年3月期の1株当たりの期末配当は、100円の普通配当に25円の記念配当を加え、合計125円を配当することといたしました。

なお、本件につきましては、平成30年6月下旬に開催予定の定時株主総会において付議する予定であります。

### 自動車関連事業

米国の政権交代に伴い、完成車メーカーによる周辺諸国への設備投資が一時的に停滞したことなどの影響があるものの、今後は堅調に進むと見られ、また中国・日本・欧州・インド・東南アジアなど販売増加により増加の見通し。国内は、需要が回復し、堅調推移の見通し。弊社は、電気自動車（EV）は引き続き受注拡大が期待できる。

### 半導体関連事業

半導体関連市場においては、自動車や家電等、様々な製品に半導体製品が使用されるようになったことから引き続き拡大。有機ELパネルにおいては、パソコン、スマートフォン、タブレットへの採用増加、ディスプレイの大型化や4K普及により市場は続伸。弊社は、有機ELパネルの蒸着装置と半導体関連装置共に堅調に推移する見込み。

### 家電関連およびその他

特に東南アジア諸国における高機能家電の浸透が進む見込み。弊社は、主要顧客における掃除機を中心とした高機能家電の生産設備の受注が期待できる。

# Ⅲ. 参考資料

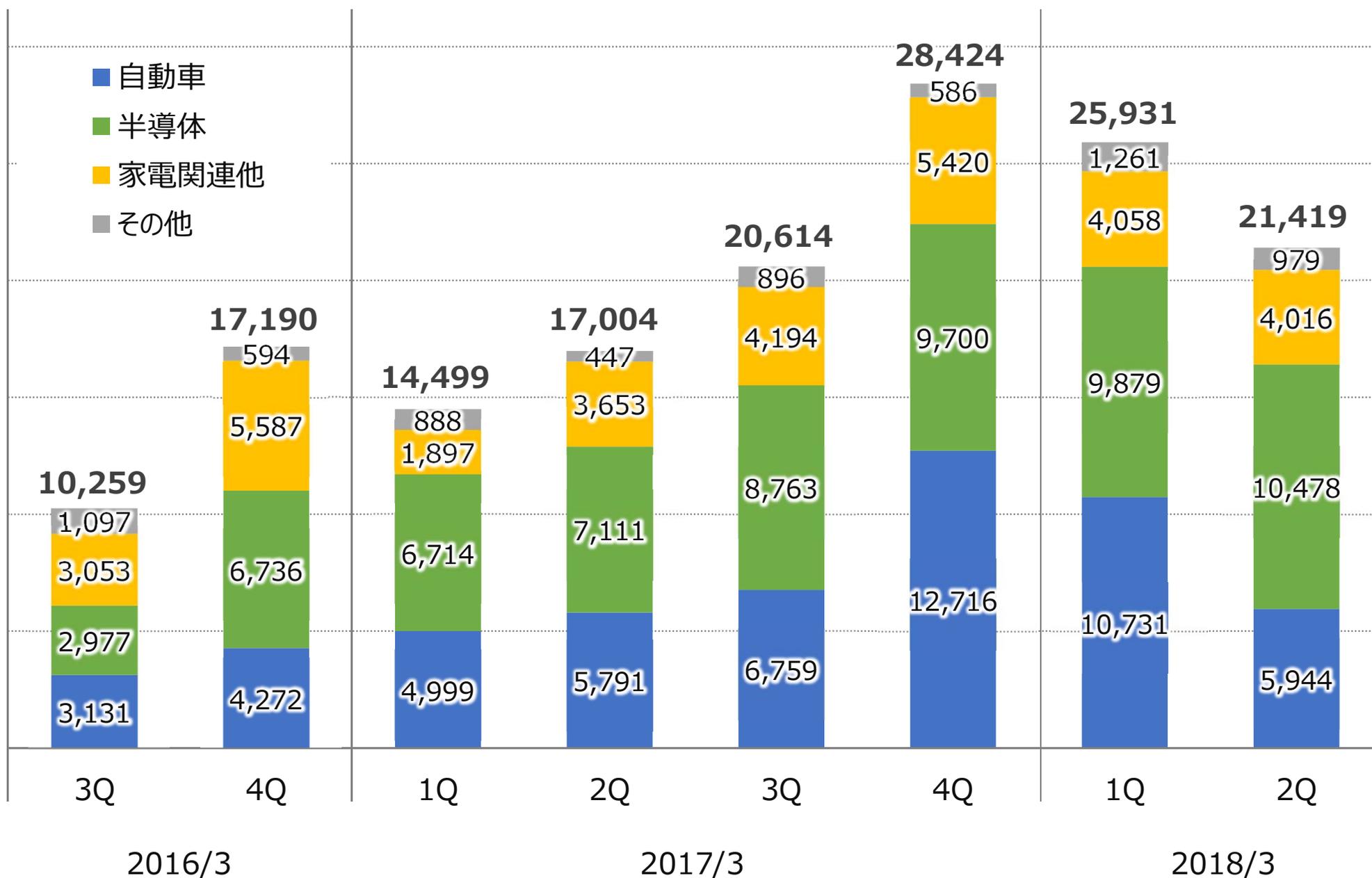
2018年3月期 第2四半期

Hirata



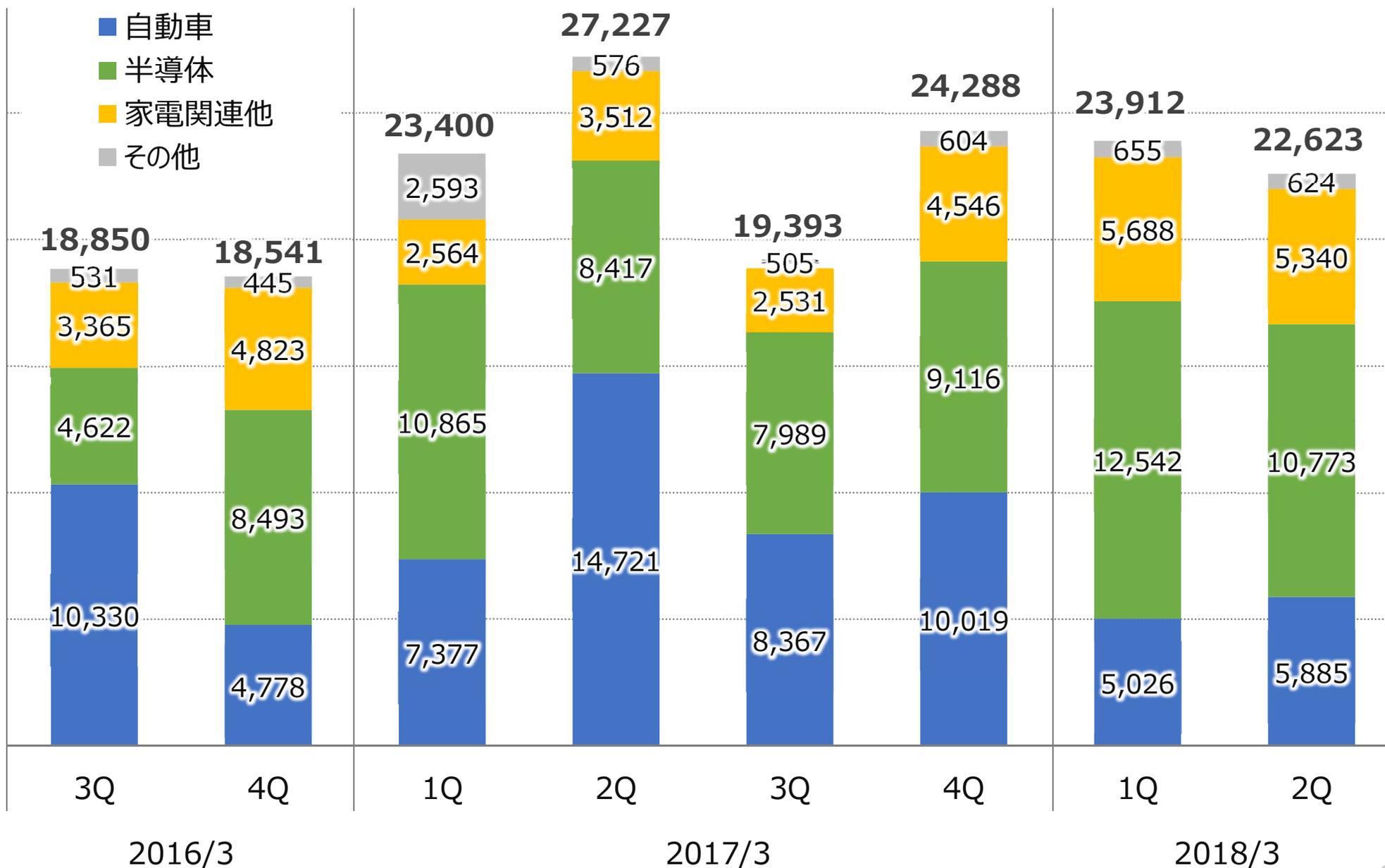
## 事業部門別四半期売上高の推移

(単位：百万円)



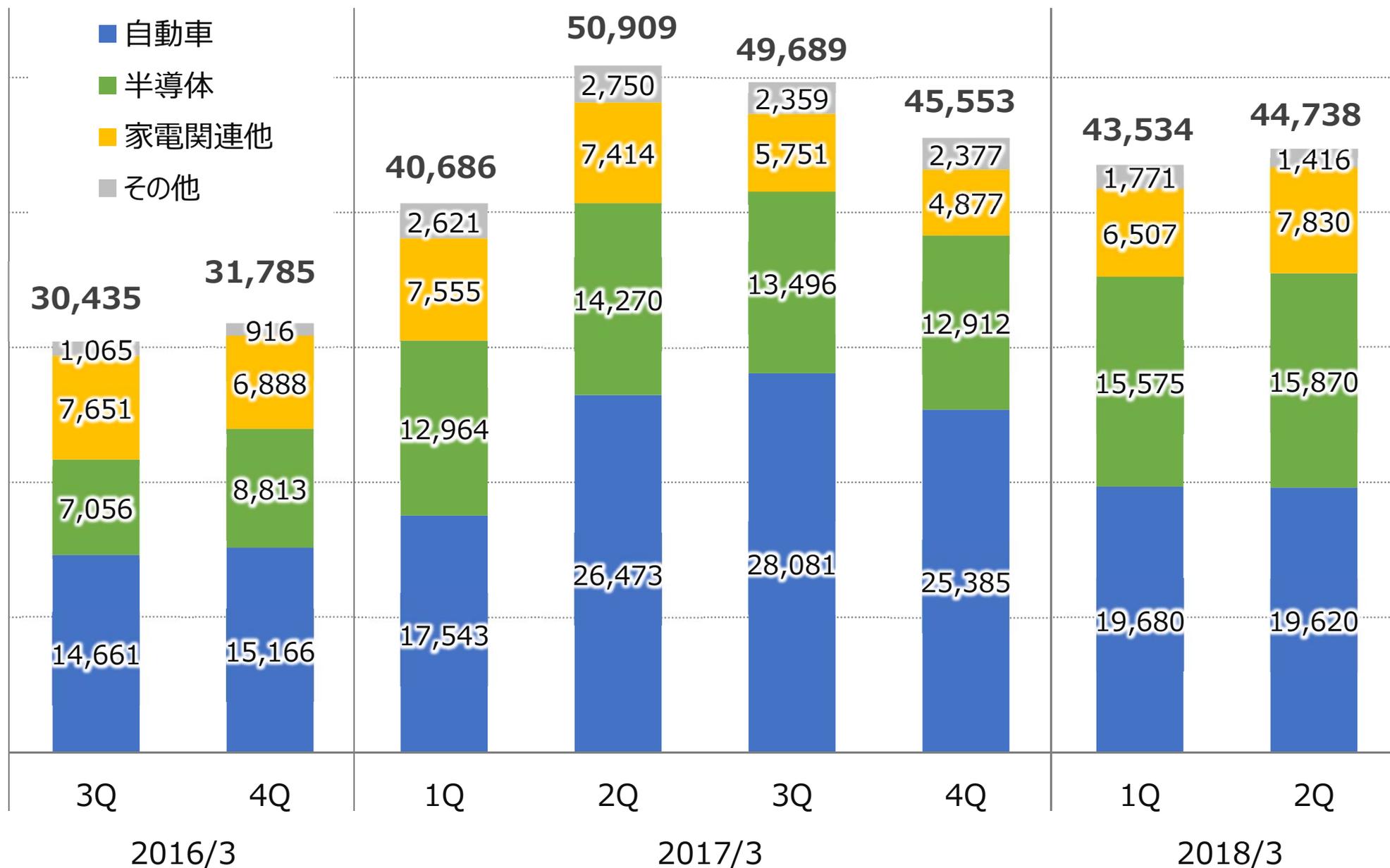
## 事業部門別四半期受注高の推移

(単位：百万円)

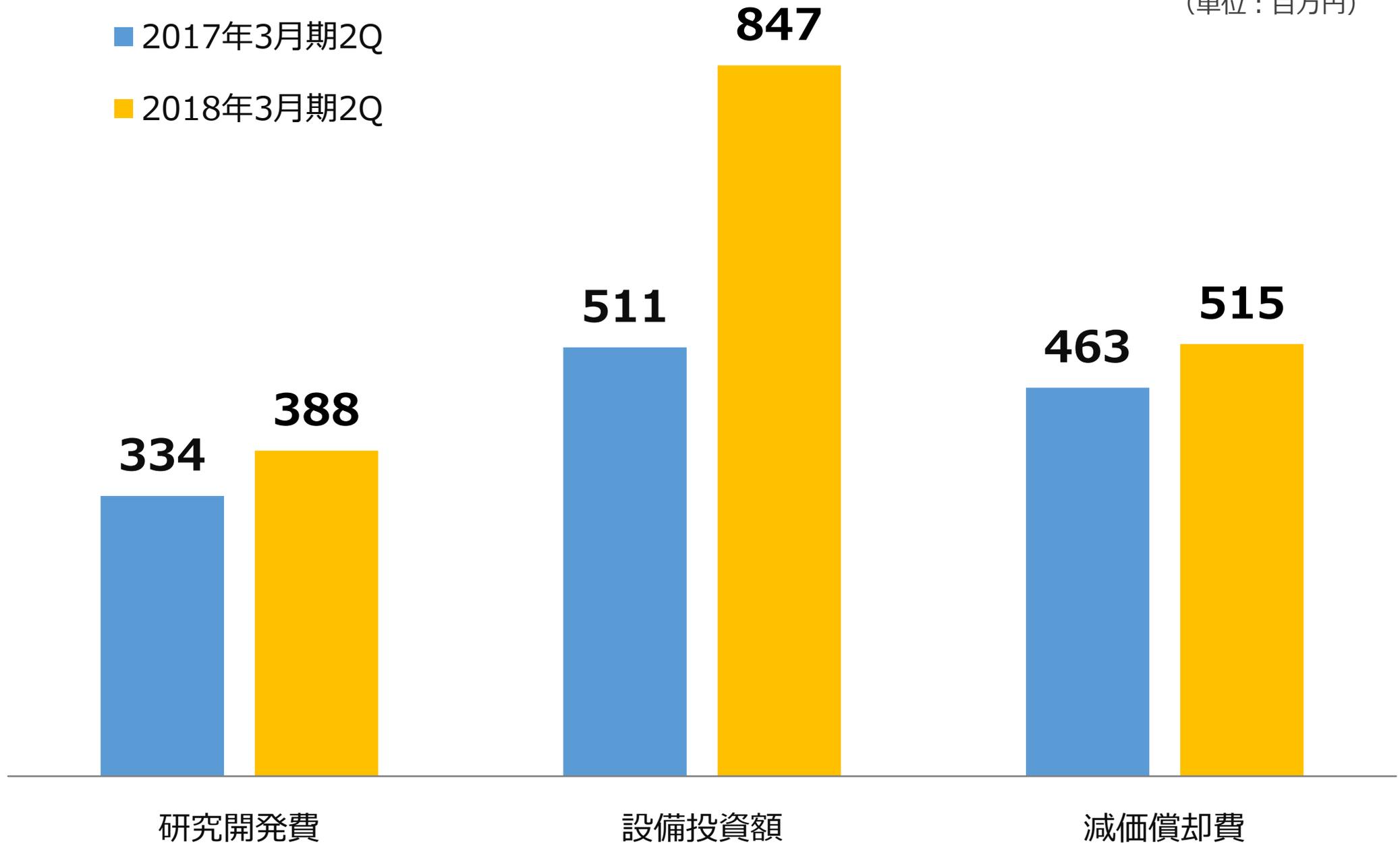


## 事業部門別四半期受注残の推移

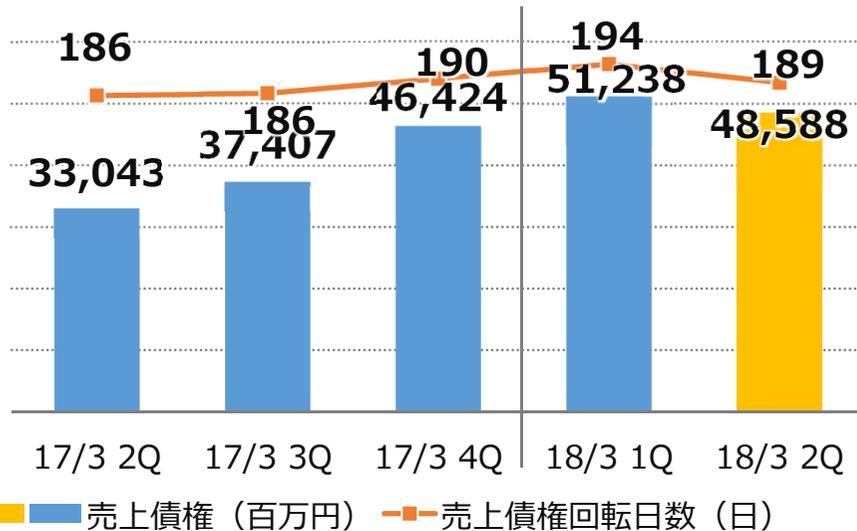
(単位：百万円)



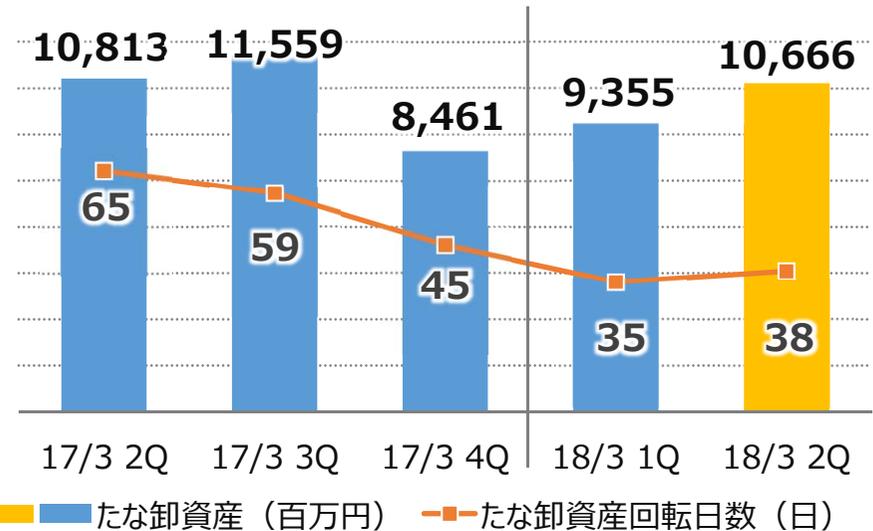
(単位：百万円)



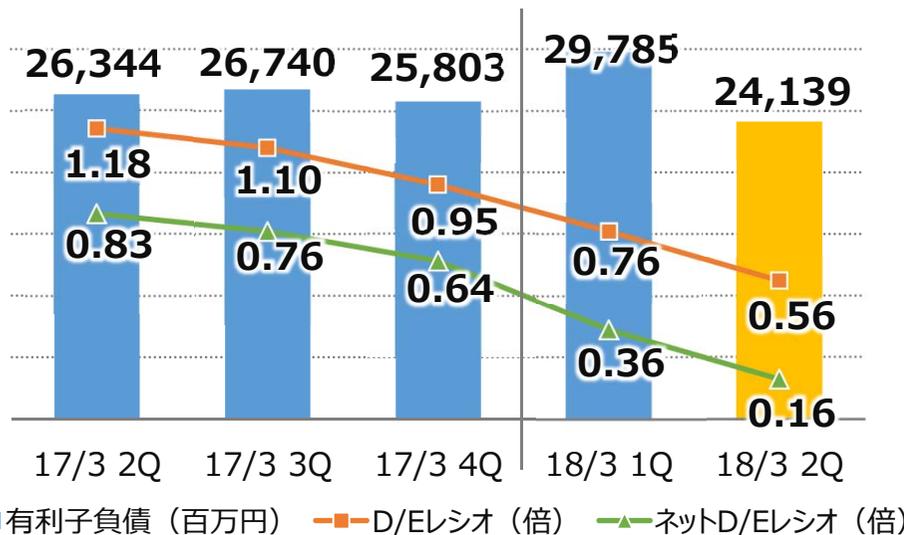
## 売上債権・売上債権回転日数



## たな卸資産・たな卸資産回転日数



## 有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



## 自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。

## ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。